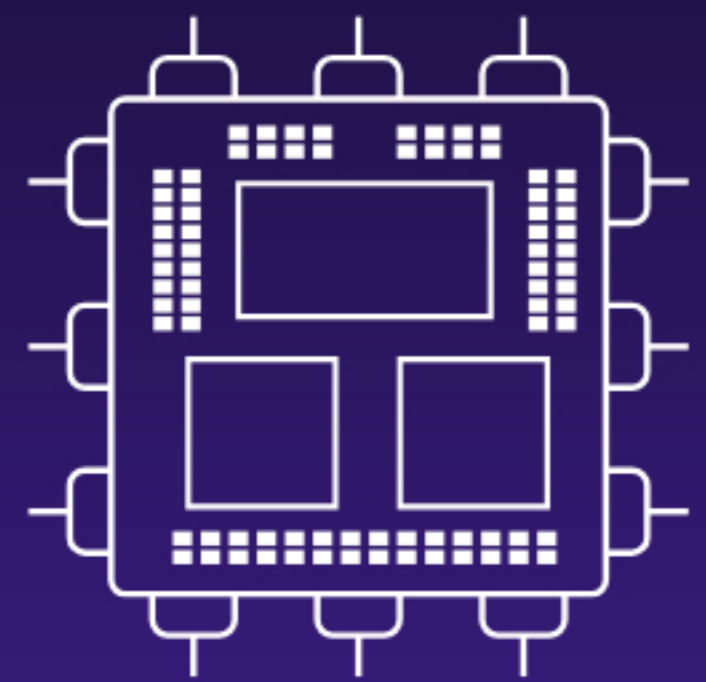


Arm 2026 年技術展望

arm

模組化小晶片 揭示晶片設計的新時代

向模組化小晶片的轉變將加速晶片創新，使晶片以高度可客製化、標準化的型態，因應多元的工作負載需求。



1

分散式 AI 驅動 邊緣端即時智慧

隨著邊緣端 AI 能力持續提升，系統與裝置得以在本地做出更快速、更智慧的決策，同時降低延遲、成本，以及對雲端的依賴。



3

實體 AI 擴展 以提升生產力

技術突破將促成可大規模擴展的次世代自主機器，為各產業帶來顯著的效率與生產力提升。



5

專用加速與系統級協同設計 定義 AI 運算

產業正朝向以特定用途為主的系統單晶片設計邁進，透過 CPU、加速器、記憶體與互連架構的緊密協同設計，最佳化 AI 運算效能。



2

更小型、專用化的 AI 模型 加速實現可觸及且高效率的 AI

針對特定領域最佳化的模型，可在不增加龐大 AI 架構負擔的情況下，為從醫療到製造等各產業開啟新商機。



4